

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gama de productos abarca los diseños siguientes:

- 90° horizontal y 180° vertical
- Bloqueo ascendente/descendente
- Procesos de soldadura THT, THR o SMD
- Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
- Categoría de rendimiento 3 a cat. 6
- Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)

Propiedades y ventajas:

- Rango de temperaturas ampliado de -40°C a +85°C para ofrecer la máxima capacidad de rendimiento
- Capa de oro reforzada (30 µm) para ofrecer una protección mejorada frente a la corrosión
- La distancia de al menos 3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto

Datos generales para pedido

Tipo	RJ45C5 S1V 2.7N4N RL
Código	1433900000
Versión	Conector para placa c.i., Conectores RJ45, Cat. 5 , Conexión por soldadura SMD, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30-80 µm Ni / 30-µm Au , LED: No, Número de polos: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118238587
U.E.	300 Pieza
Embalaje	Tape

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	16,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,634 inch
Altura	13,2 mm	Altura (pulgadas)	0,52 inch
Altura construcción baja	13,2 mm	Profundidad	20,05 mm
Profundidad (pulgadas)	0,789 inch	Peso neto	3,467 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Especificaciones del sistema

Angulo de salida	180°	Anilla de apantallado	ninguno
Apantallamiento	Sí	Categoría	Cat. 5
Ciclos de enchufado	750	Familia del producto	Datos OMNIMATE - Conectores RJ45
LED	No	Longitud del terminal de soldadura (l)	3,5 mm
Material del apantallamiento	aleación de cobre	Modo de conexión	8 núcleos
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura SMD	Número de polos	8
Número de terminales de soldadura por polo	1	Paso en mm (P)	1,27 mm
Paso en pulgadas (P)	0,05 inch	Superficie de apantallado	niquelado
Tipo de conexión	Conector hembra	Tipo de protección	IP20

Propiedades eléctricas

Intensidad nominal	1,5 A	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V DC
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ	Tensión nominal	125 V AC

Datos del material

Materiales aislantes	PA 9T	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	II
CTI	≥ 500	Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material del contacto	Fósforo, bronce	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Estructura de capas de la conexión por soldadura	30-80 μ" Ni / 30- μ" Sn	Estructura de capas del contacto del conector	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	85 °C

Embalaje

Embalaje	Tape	Longitud de VPE	50 mm
Anchura VPE	330 mm	Altura de VPE	330 mm
Diámetro de bobina de cinta Ø (A)	330 mm	Resistencia superficial	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

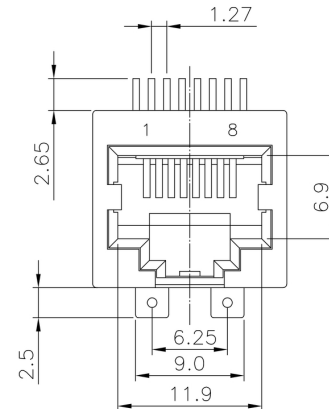
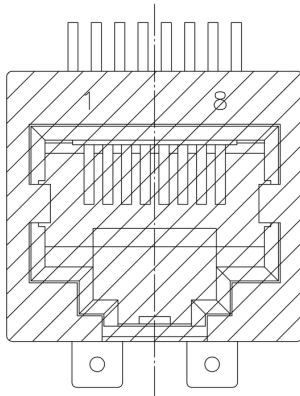
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

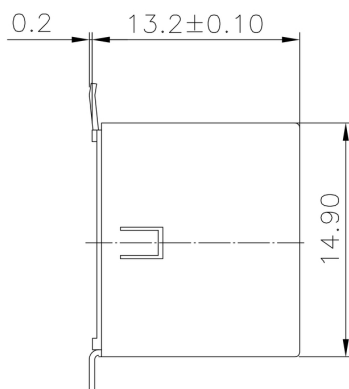
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

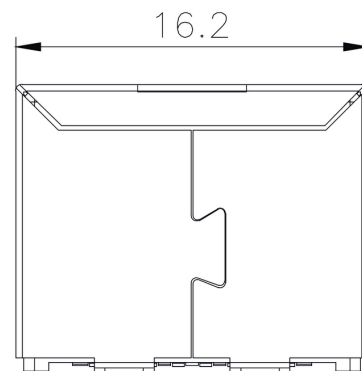
Dibujo acotado



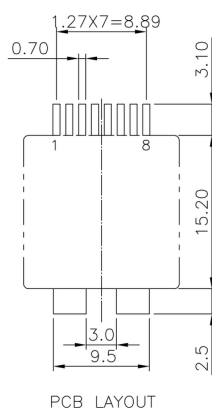
Dibujo acotado



Dibujo acotado



Dibujo acotado



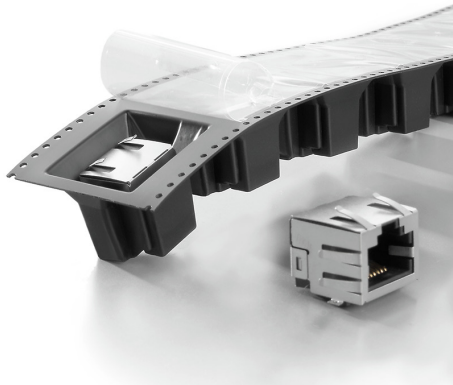
Dibujo acotado

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

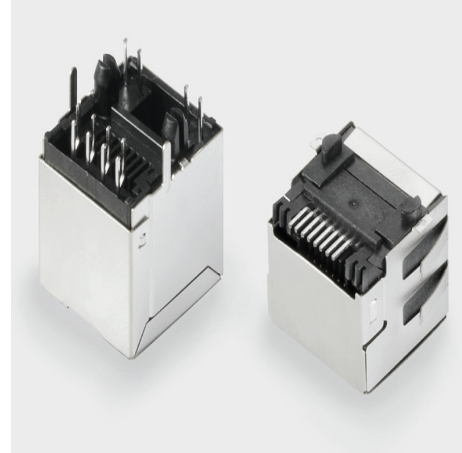
Ventaja del producto



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Ventaja del producto

Ventaja del producto



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 14:05:59 CEST

Datos OMNIMATE - Conectores RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

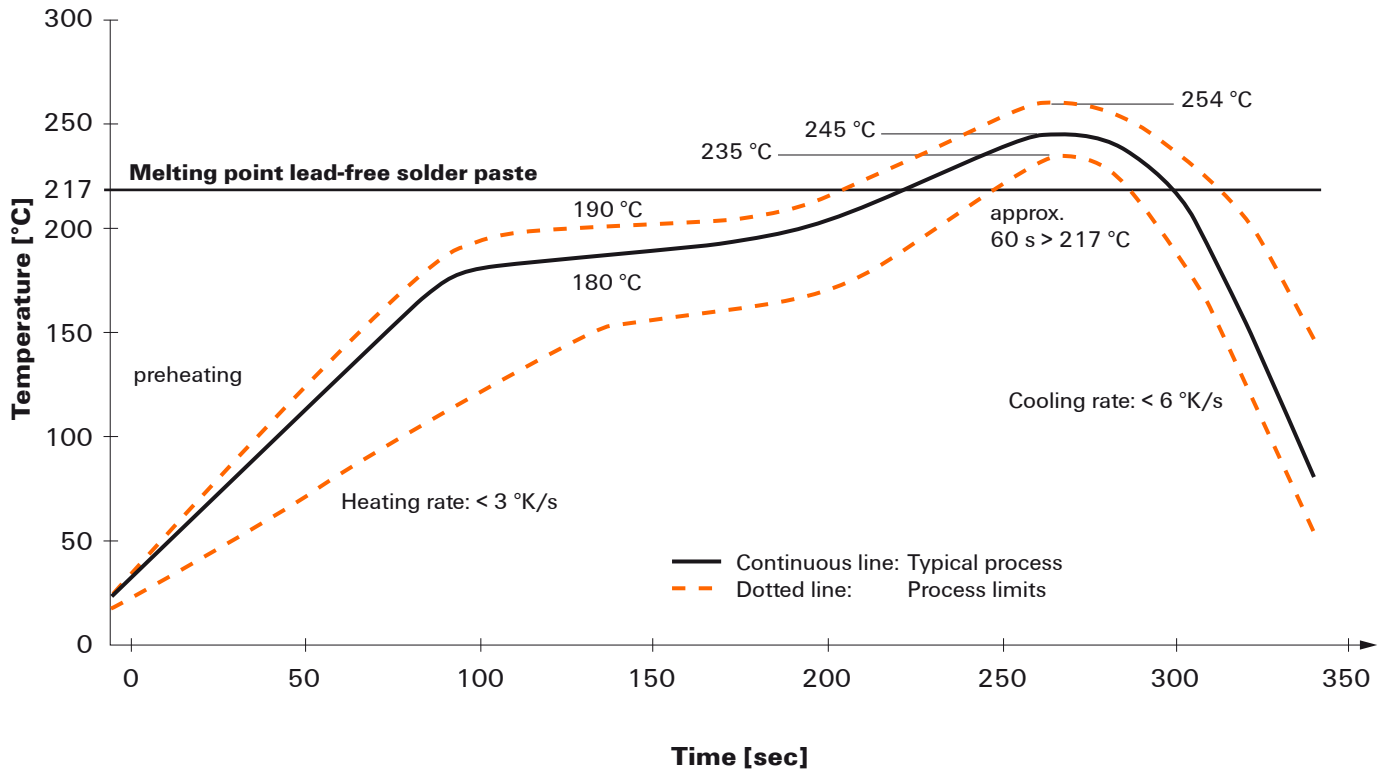
Dibujos

Leyenda

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
</										

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.